

北京赛微电子股份有限公司

关于公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京赛微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开的第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》，现将有关情况公告如下：

为满足公司经营和未来发展资金需求、结合公司实际情况，公司及公司合并报表范围内子公司拟在2026年度向银行申请合计不超过40.10亿元的综合授信额度，其中公司拟申请5.00亿元的综合授信额度，公司合并报表范围内子公司拟申请合计不超过35.10亿元的综合授信额度。授信用途包括但不限于固定资产贷款、流动资金贷款、票据承兑和贴现、信用证等，上述授信事项有效期为自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。

上述综合授信额度不等同于公司实际融资金额，具体数额、贷款期限等以公司及子公司根据资金使用计划与相关银行签订的最终协议为准。在授信期限内，授信额度可循环使用。

公司控股股东、实际控制人、董事长杨云春先生拟为公司申请的综合授信额度提供连带责任担保；公司及公司控股股东、实际控制人、董事长杨云春先生拟为公司子公司申请的综合授信额度提供连带责任担保。具体担保的金额与期限等以公司及子公司根据资金使用计划与相关银行签订的最终协议为准，公司及子公司免于支付担保费用。

公司董事会授权公司及子公司法定代表人（或其授权代表）签署与上述事项相关的法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司及子公司承担。

特此公告。

北京赛微电子股份有限公司董事会

2026年3月26日